

工作職稱：NXP Semester Intern

工作地點：高雄市楠梓區經五路 10 號（NXP 半導體）

工作日期：7 月 – 12 月

工作天數：暑期每週 5 天，開學後每週三天（含）以上

工作時間：08:15 – 17:00

工作內容：

1. 利用資料分析，定義關鍵製程因子，包含封裝研磨/切割/雷射切割/雷射打印製程
2. 以巨量數據分析，找出製程變因因子，穩定製程條件
3. 比較機台間運作時間差異，改善生產效率
4. 建立數據分析模型，發展預知保養

需求背景：

1. 大三/碩一/博士在學生，數理統計 / 資工 / 資管背景優先。
2. 主動積極，具好奇心探索事物，具溝通能力。
3. 熟悉 R / Python / 資料分析技術優先